

## 深圳佰维存储科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录汇总表

(2025年3月4日-3月11日)

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 专场机构交流会 <input type="checkbox"/> 其他 _____	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观
参与单位名称及人员姓名	国寿养老 汪洋、国寿养老 侯英杰、华泰证券 林文富、亿能投资 张勳凯、亿能投资 肖焜锬、亿能投资 周文辉、前海方舟 李长谦、前海方舟 刘端子靖、前海方舟 马岳庚、荣炜基金 汪敬波、前海华霖 林婧如、前海华霖 曾以刚、百联集团 沈琪超、鲁花道生 乔立、亿库资本 洪刚、亿库资本 黄立能、亿库资本 吴嘉聪、中盈发展 陈敏、中盈发展 黄筱烨、国泰君安资管 高海峰、玄元私募 谢智莲、国泰租赁 夏晨星、苏高新产投 曹昱、善思投资 张伟、善思投资 郑建鑫、善思投资 林泰澄、Monolith Management Shengyu Su、Citadel Zhiyi Zhou、Capstone Capital Alan Dong、Balyasny Asset Management Feiyang Zhu、Aqua Lake Fund Jimmy Zheng、UBS Jimmy Yu、UBS Kevin Cheng、UBS Scarlett Ge、UBS 吴翰文、Triata Capital Sean Wang、招商基金 袁哲航	
会议时间	2025年3月4日 15:00-16:00 2025年3月6日 14:00-17:00 2025年3月7日 15:00-16:00 2025年3月11日 11:00-12:00	
会议地点	佰维存储三楼会议室 佰维存储惠州封测制造中心二楼会议室	
上市公司接待人员姓名	公司管理层 董办工作人员	
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>Q1. 请问公司在哪些应用领域推出了 SSD 产品？产品市场表现如何？</b></p> <p>A1: 在嵌入式存储领域，公司 BGA SSD 已通过 Google 准入供应商名单认证，在 AI 移动终端、云手机、高性能超薄笔记本、无人机、智能汽车等领域具有广泛的应用前景；在 PC 存储领域，公司 SSD 产品目前已经进入联想、Acer、HP、同方等国内外知名 PC 厂商，公司是国产 PC 领域 SSD 产品的主力供应商，占据优势份额；在工车规存储领域，公司已推出 SATA SSD、PCIe SSD 等 SSD 产品，满足工车规客户的不同需求与场景；在企业级存储领域，公司已推出企业级 SATA SSD、企业级 PCIe SSD 等产品，主要应用于数据中心、通用服务器、AI/ML 服务器、云计算、大数据等场景；在移动存储领域，公司推出了移动固态硬盘，主要应用于消费电子领域，具有高性能、高品质的特点，并具备创新的产品设计。</p> <p><b>Q2. 公司对于 DDR5/LPDDR5X 等高端存储芯片，采取了哪些具体措施来保证产品性能与质量？</b></p>	

	<p>A2: 公司在 2022 年引进全球领先的 Advantest（爱德万）T5503HS2 量产测试系统，与公司自研的全自动化测试设备相结合，进一步强化了公司全栈存储芯片测试能力，结合丰富的自研测试算法库，可以对 DDR5/LPDDR5X 等高端芯片进行全面的特性分析，保证产品品质，并达到客户要求的高性能指标。</p> <p><b>Q3. 请问泰来科技能够提供哪些封装服务？技术水平如何？</b></p> <p>A3: 泰来科技（佰维惠州封测制造中心）封装工艺国内领先，目前掌握 16 层叠 Die、30~40μm 超薄 Die、多芯片异构集成等先进工艺量产能力，达到国际一流水平。泰来科技目前可提供 Hybrid BGA（WB+FC）、WB BGA、FC BGA、FC CSP、LGA、QFN 等封装形式的代工服务。未来，随着产能不断扩充，泰来科技将利用富余产能向存储器厂商、IC 设计公司、晶圆制造厂商提供代工服务，形成新的业务增长点。</p> <p><b>Q4. 请问国产存储的市场前景如何？未来的增长动力有哪些？</b></p> <p>A4: 目前，国产 DRAM 和 NAND Flash 芯片市场份额较低，发展前景较大。在中国“互联网+”、大力发展新一代信息技术和不断加强先进制造业发展的战略指引下，国内信息化、数字化、智能化进程加快，用户侧的 AI、短视频、直播、游戏、社交网络等应用和制造侧的工业智能化逐渐普及，刺激存储芯片的市场需求快速增长。2014 年以来，中国成为全球最大的消费电子市场，并开始扮演全球消费电子行业驱动引擎的角色。此外，5G、物联网、数据中心等新一代信息技术在中国大规模开发及应用，也催生了我国对半导体存储器的强劲需求。随着国内存储器产业链的逐步发展和完善，以公司为代表的存储器研发封测一体化厂商也迎来了发展机遇。</p> <p><b>Q5. 请问公司如何在存储技术及产品方面构建竞争优势？</b></p> <p>A5: 公司聚焦于半导体存储器产品的研发与创新，所涉及技术领域主要包括存储解决方案研发、芯片设计、先进封测、测试设备研发等领域。在存储解决方案研发方面，公司能够为 AI 手机、AIPC、AI 服务器、智能穿戴、智能汽车等领域客户提供大容量、大带宽、低延时、低功耗、高安全、小尺寸等存储解决方案。在芯片设计领域，公司第一款 eMMC（SP1800）国产自研主控已完成批量验证，性能优异，支持 QLC 颗粒，采用创新架构设计以及 4K LDPC 算法和 SRAM ECC 纠错功能。在先进封测领域，公司构建了存储+晶圆级先进封测能力，在满足先进存储封装需求的同时，可以与公司存储业务协同，服务公司客户对于存算合封业务的需求，为相关客户提供封测服务。在测试设备领域，公司自主开发了一系列存储芯片测试设备和测试算法，构建了一站式芯片测试解决方案。公司持续加大研发投入，根据公司发布的《2024 年年度业绩快报》，2024 年度研发费用 45,184.98 万元，同比增长 80.75%。</p> <p><b>Q6. 请问公司产品获得了哪些主要 CPU、SoC 及系统平台厂商的认证？</b></p> <p>A6: 半导体存储器作为电子系统的核心部件之一，需要与 CPU、SoC 及系统平台匹配验证。CPU、SoC 及系统平台认证过程严格，对企业的技术能力，产品的性能、可靠性和一致性等均有较高要求。公司是国内半导体存储器厂商中通过 CPU、SoC 及系统平台认证最多的企业之一，公司的主要产品已进入高通、Google、英特尔、联发科、展锐、晶晨、瑞芯微、全志、瑞昱、君正等主流 CPU、SoC 及</p>
--	---

	<p>系统平台厂商的 AVL（Approved Vendor List 合格供应商清单）名录。</p> <p><b>Q7. 请问公司目前采取怎样的备货策略？</b></p> <p>A7：自 2024 年以来，公司采取较为中性的备货策略，以销定采。</p>
<b>附件清单</b>	无
<b>日期</b>	2025 年 3 月 4 日-3 月 11 日
<b>备注</b>	接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息披露等情况。